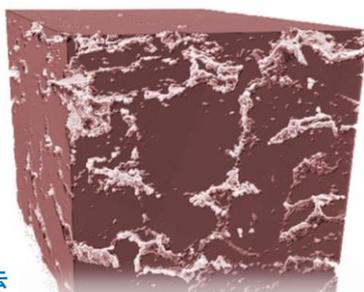
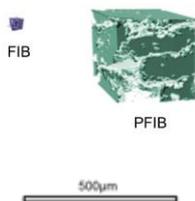


Multi Scale Imaging Technology Web Seminar

Thermo Scientific Helios 5 PFIB / Laser



最大で数ミリまで高速材料除去

PFIBはおよそ250µm、PFIB + laser複合装置では1mm まで評価領域を拡大
大まかな除去に1分程度で処理し、(P)FIBでは1mA以上に相当する
並行照射によりミリメートル深さに加工可能

炭素材料の高速除去 (e.g. グラファイトや炭素繊維強化プラスチック)

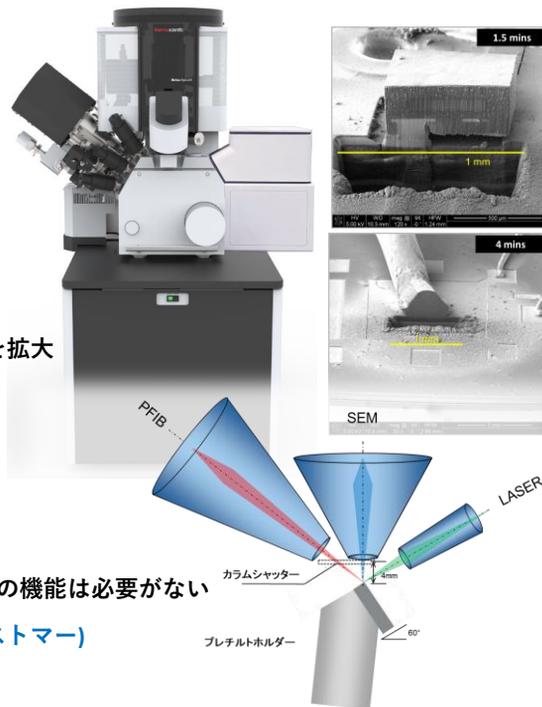
(P) FIBではゆっくりとした加工。時間を要す。

絶縁材料の高速除去 (e.g. ガラス、セラミックス、ポリマー)

レーザー加工時には帯電は起きない (P) FIBのように帯電補正などの機能は必要がない

有機材料は冷却機能を必要とせず加工が可能 (e.g. ソフトポリマー、エラストマー)

試料放電なし



Avizo / Amira Software for Image Analysis

フレキシブルなワークフローとセグメンテーション

ワークフローのトレーサビリティ

対象画像に合わせた最適なセグメンテーション法の選択

自由な解析ワークフローの構築

高品質な3Dビジュアライゼーション

TEM, FIB/SEM, X線CT、光学顕微鏡等の様々な装置画像に対応

200種類を超える解析 (統計) 結果の提供

簡便に行えるDeep Learning(DL)セグメンテーション

コーディング無しで扱えるDLモジュールの搭載

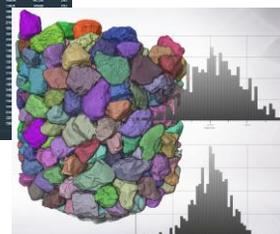
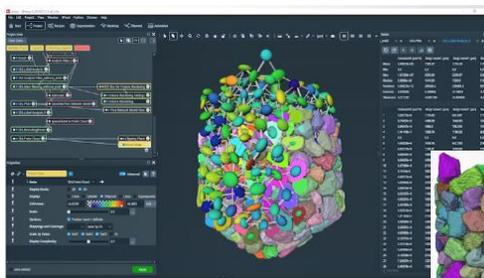
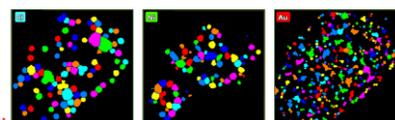
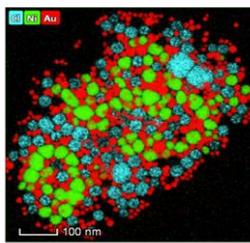
アプリケーション

電池、多孔質材、磁性材、フィルター、触媒、生体組織

人口骨、航空機材、繊維強化プラスチック、フィラー分散剤、

自動車部品、プリンターナー、光学 (膜) 材、鉄鋼材、化粧品

半導体デバイス, etc



Amira-Avizo.com お問い合わせは sw-info-jp@fei.com

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.